

GSM-MIG CuSn

GSM-WIG CuSn

Normbezeichnung:

EN ISO 24373: S Cu 1898 AWS A-5.7: ERCu	DIN 1733: SG-CuSn Werkstoff-Nr.: 2.1006	EN ISO 24373: S Cu 1898 AWS A-5.7: ERCu	DIN 1733: SG-CuSn Werkstoff-Nr.: 2.1006
--	--	--	--

Zulassungen:

Eine aktuelle Zulassungsübersicht ist bei Bedarf anzufordern!

Anwendungsbereich:

Mit Sn legiertem Kupferschweißmaterial für MIG- und WIG-Schweißen. GSM MIG/WIG CuSn ist geeignet für Kessel und Rohre aus Kupfer oder Kupferlegierungen. Das Schweißmaterial hat eine gute elektrische Leitfähigkeit, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und sehr gute Desoxidation. Geeignet für Bronzelegierungen mit mindestens 0,8% Zinn. Verwendbar zur Oberflächenbehandlung und Verbindung von Cu und Kupferlegierungen. Weit verbreitet beim Ofenlöten.

Wichtigste Grundwerkstoffe:

Schweißgeeignete Kupfersorten, z.B.:

2.0070	SE-Cu	2.0076	SW-Cu
2.0090	SF-Cu	2.0040	OF-Cu

Richtanalyse des reinen Schweißgutes:

Cu	Sn	Si	Mn
Basis	1	0,5	0,5

Mechanische Gütewerte des reinen Schweißgutes:

Dehngrenze $R_{p0,2}$ [MPa]	Zugfestigkeit R_m [MPa]	Dehnung A_5 [%]	Kerbschlagarbeit K_V [J]	Härte [HB]
100	210	30	70 (+20°C), 60 (-196°C)/ 80 (+20°C), 60 (-196°C)	60

Verarbeitungshinweise:

Schweißposition MSG / WSG	Schutzgas MSG / WSG	Betriebstemperatur
PA, PB, PF / PA, PB, PC, PE, PF	I1	---

Bestellinformationen:

MSG auf Spule zu je 15 kg/VPE, 960 kg/EP		WSG zu je 5 kg/VPE, 25 kg/KRT, 960 kg/EP	
Abmessung MSG	Artikelcode	Abmessung	Artikelcode
0,8	412-2608	1,0 x 1000	409-1010
1,0	412-2610	1,2 x 1000	409-1012
1,2	412-2612	1,6 x 1000	409-1016
		2,0 x 1000	409-1020
		2,4 x 1000	409-1024
		3,2 x 1000	409-1032
		4,0 x 1000	409-1040
		5,0 x 1000	409-1050